

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月4日(04.09.2025)



(10) 国際公開番号

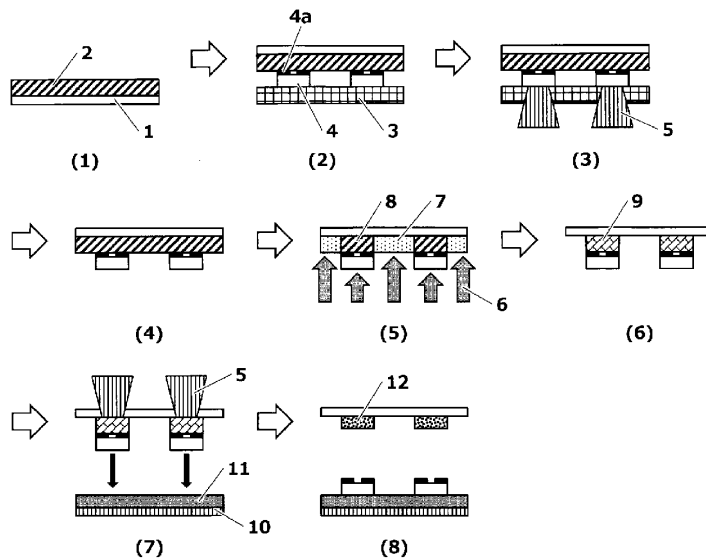
WO 2025/182702 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/023 (2006.01) G09F 9/00 (2006.01)
G03F 7/20 (2006.01) G09F 9/33 (2006.01)
G03F 7/037 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2025/005531
- (22) 国際出願日: 2025年2月19日(19.02.2025)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2024-028298 2024年2月28日(28.02.2024) JP
- (71) 出願人: 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 (JP).
- (72) 発明者: 谷 垣 勇 剛 (TANIGAKI Yugo); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 (JP). 石田 昂 己 (ISHIDA Koki); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 (JP). 宮崎 大地 (MIYAZAKI Daichi); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,

(54) Title: LAMINATE AND LAMINATE PRODUCTION METHOD

(54) 発明の名称: 積層体及び積層体の製造方法

[図1]



(57) Abstract: Provided is a laminate production method that realizes both debris inhibition and excellent positioning accuracy in transferring articles such as semiconductor chips. A high-quality display device or semiconductor device can be obtained by said laminate production method. The present invention is a laminate production method having: a step for preparing a laminate a1x having a first substrate and a light absorption layer in the stated order; a step for temporarily fixing articles to the light absorption layer; a step for pattern-processing the light absorption layer; a step for preparing a

[続葉有]

CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

laminate a2 having a second substrate and a second adhesion layer in the stated order; and a step for irradiating the light absorption layer with an activated actinic ray from the first substrate side of the light absorption layer in a state of having a gap between the articles provided to the first substrate and the second adhesion layer provided to the second substrate, to thereby transfer the articles from the light absorption layer to the second adhesion layer. The plurality of articles are in contact with the light absorption layer. Recess parts are formed on the light absorption layer.

(57) 要約: 半導体チップ等の物品転写時のデブリ抑制と優れた位置精度とを兼ね備える積層体の製造方法を提供する。該積層体の製造方法により、高品質な表示装置や半導体装置を得ることができる。本発明は、第1基板及び光吸収層をこの順に有する積層体 a 1 x を準備する工程; 光吸収層に物品を仮固定する工程; 光吸収層をパターン加工する工程; 第2基板及び第2粘着層をこの順に有する積層体 a 2 を準備する工程; 及び第1基板に備えられた物品と、第2基板に備えられた第2粘着層との間に間隙を設けた状態で、光吸収層の第1基板側から光吸収層に活性化学線を照射し、物品を光吸収層から第2粘着層に転写する工程、を有する積層体の製造方法であって、該光吸収層に接する複数の物品を有し、かつ該光吸収層に凹部を形成する、積層体の製造方法である。